证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2021-004

嘉兴斯达半导体股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年2月22日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年3月2日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,经对公司实际情况逐项自查论证,认为公司已符合非公开发行A股股票的各项条件。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了非公开发行A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的方案。 公司董事会逐项审议本方案项下的以下事项,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后, 由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间, 公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10%, 即不超过16,000,000股 (含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点

本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)本次发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前的滚存未分配利润,将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)本次决议的有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目	200,000.00	200,000.00
2	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		350,000.00	350,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经公司股东大会授权,公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过后,按照相关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定的要求,就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于公司 2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定的要求,就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施;同时,为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,相关主体对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《嘉兴斯达半导体股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

为保证公司本次非公开发行A股股票的顺利实施, 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关的事宜。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)等相关规定的要求,公司编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,该报告已经《嘉兴斯达半导体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》鉴证。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)及《公司章程》等相关规定,并结合公司的实际情况,公司编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定,现提请于2021年3月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021年3月2日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2021-003

嘉兴斯达半导体股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2021年2月22日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年3月2日以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,经对公司实际情况逐项自查论证,认为公司已符合非公开发行A股股票的各项条件。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司拟定了非公开发行A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的方案。公司董事会逐项审议本方案项下的以下事项,表决结果如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后, 由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间, 公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的10%, 即不超过16,000,000股 (含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)上市地点

本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)本次发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前的滚存未分配利润,将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)本次决议的有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目	200,000.00	200,000.00
2	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		350,000.00	350,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经公司股东大会授权,公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过后,按照相关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

三、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行A股股票预案的议案》

公司董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定的要求,就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于公司 2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定的要求,就本次非公开发行股票相关事宜编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施;同时,为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,相关主体对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《嘉兴斯达半导体股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)等相关规定的要求,公司编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,该报告已经《嘉兴斯达半导体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》鉴证。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关报告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)及《公司章程》等相关规定,并结合公司的实际情况,公司编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会
2021年3月2日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2021-006

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规及规范性文件的规定,为保障中小投资者利益,嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“斯达半导”或“公司”)就本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2020年度和2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(一)假设前提

1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化;

2、假设公司本次非公开发行于2021年8月实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

3、假设本次非公开发行股票的募集资金总额上限为350,000万元(不考虑发行费用的影响),发行股份数量上限为16,000,000股(含本数)。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、上述募集资金总额、发行数量仅为估计值,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额和发行数量;

5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以本次发行前截至本预案公告日前总股本160,000,000股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生变化;

6、公司2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润为13,412.76万元(未经审计),扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,553.93万元(未经审计);

7、假设2020年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2020年第三季度报告披露数据的4/3倍, 分别为17,883.68万元及15,405.24万元;2021年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2020年的基础上按照持平、增长10%、增长20%三种情景分别计算;

8、该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度、2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策;

9、假设公司2020年度现金分红比例与2019年度保持一致,即为30%,2020年现金分红5,365.10万元,且于2021年4月通过股东大会审议,2021年6月实施完毕;

10、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

11、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

项目	2019年度/2019.12.31	2020年度/2020.12.31	2021年度/2021.12.31	
			本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	12,000.00	16,000.00	16,000.00	17,600.00
本次非公开增发股份数量(万股)				1,600.00
假设一:	公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润皆与2020年度持平			
归属于母公司净利润(万元)	13,527.85	17,883.68	17,883.68	17,883.68
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,988.22	15,405.24	15,405.24	15,405.24
当期现金分红(万元)	999.12	4,064.00	5,365.10	5,365.10
IPO增加净资产(万元)	–	45,949.33	–	–
非公开增加净资产(万元)	–	–	–	350,000.00
期初归属母公司股东的权益(万元)	43,413.25	55,967.20	115,736.21	115,736.21
期末归属母公司股东的权益(万元)	55,967.20	115,736.21	129,254.78	478,254.78
基本每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.12	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.12	1.08
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	1.00	1.00	0.96	0.93
扣除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	1.00	1.00	0.96	0.93
加权平均净资产收益率	27.23%	17.14%	14.77%	7.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.13%	14.77%	12.72%	6.48%
假设二:	公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2020年度增长10%			
归属于母公司净利润(万元)	13,527.85	17,883.68	19,672.05	19,672.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,988.22	15,405.24	16,945.77	16,945.77
当期现金分红(万元)	999.12	4,064.00	5,365.10	5,365.10
IPO增加净资产(万元)	–	45,949.33	–	–
非公开增加净资产(万元)	–	–	–	350,000.00
期初归属母公司股东的权益(万元)	43,413.25	55,967.20	115,736.21	115,736.21
期末归属母公司股东的权益(万元)	55,967.20	115,736.21	130,043.15	480,043.15
基本每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.23	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.23	1.19
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.06	1.02
扣除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.06	1.02
加权平均净资产收益率	27.23%	17.14%	16.13%	8.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.13%	14.77%	13.89%	7.10%
假设三:	公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2020年度增长20%			
归属于母公司净利润(万元)	13,527.85	17,883.68	21,460.41	21,460.41
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,988.22	15,405.24	18,486.29	18,486.29
当期现金分红(万元)	999.12	4,064.00	5,365.10	5,365.10
IPO增加净资产(万元)	–	45,949.33	–	–
非公开增加净资产(万元)	–	–	–	350,000.00
期初归属母公司股东的权益(万元)	43,413.25	55,967.20	115,736.21	115,736.21
期末归属母公司股东的权益(万元)	55,967.20	115,736.21	131,831.52	481,831.52
基本每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.34	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.17	1.34	1.30
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.16	1.12
扣除非经常损益后稀释每股收益(元/股)	1.00	1.00	1.16	1.12
加权平均净资产收益率	27.23%	17.14%	17.46%	8.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.13%	14.77%	15.04%	7.72%

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降, 股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

同时,在相关法律法规下,公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中对2020年和2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施,并不构成公司的盈利预测,填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行的必要性和合理性详见公司同日披露的《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

公司长期致力于IGBT及快恢复二极管芯片、SiC芯片等功率芯片的设计和工艺以及IGBT模块、SiC模块等功率模块的设计、制造和测试。公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。公司在现有产品结构的基础上,充分考虑轨道交通、智能电网、新能源汽车等下游行业的需求以及技术方向,以公司现有的技术为依托,实施高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目。项目的实施有利于丰富公司的产品结构,进一步提升公司综合竞争力。

1、高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目

目前公司在650V、750V、1200V、1700V等中低压IGBT芯片已经实现国产化, 但是在3300V、4500V等高压功率芯片及在SiC芯片等细分产品上仍依赖进口,急需国产化以提高公司的竞争力。

公司本次非公开发行股票的高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目,拟在现有技术积累上,把握智能电网、轨道交通等关键基础设施的核心模块安全可控的政策引领和功率半导体器件向第三代材料迭代升级发展趋势,向高压特色工艺功率芯片和SiC芯片领域拓展,从而达到优化产品结构,完善产品布局的目的。

2、功率半导体模块生产线自动化改造项目

公司本次非公开发行股票的功率半导体模块生产线自动化改造项目,拟采用先进技术和设备,配置全自动、在线式生产线及信息化系统,实施以IGBT模块、SiC模块为主的功率半导体模块生产线自动化改造项目。本项目的实施,有助于提升企业质量管控能力,进一步提高公司产品质量稳定性,提升企业对下游市场的供货保障能力,提高客户供应链安全性,提升企业竞争力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司董事长兼总经理沈华博士为国家特聘专家、浙江省特聘专家和中国电器工业协会电力电子分会常务理事。公司技术骨干主要是来自美国麻省理工学院、台湾清华大学、浙江大学等国际知名高校的博士或硕士,大多数具备在国际知名半导体企业承担研发工作的经历,在功率半导体芯片和模块领域有20年以上的研发和生产经验,在高压特色工艺功率半导体芯片及SiC芯片设计和制造领域拥有成熟的技术经验。此外,公司在海外设立了欧洲研发中心,其研发人员拥有在国际知名半导体公司任职多年的背景,协同母公司进行尖端芯片和模块的研发及测试。

2、技术储备

公司自成立以来一直以技术发展和产品质量为公司之根本,并以开发新产品、新技术为公司的主要工作,持续大幅度地增加研发投入,培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍。团队的技术能力涵盖了IGBT及快恢复二极管芯片、SiC芯片和IGBT模块、SiC模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等方面,在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。

3、市场储备

公司功率半导体产品销售范围已覆盖国内外的多个应用领域,主要采取直销的方式进行销售,除嘉兴本部外,公司在北京、深圳、济南、成都、南京、青岛、武汉等地设置多个销售办事处,并在瑞士设立欧洲子公司进行产品销售和服务,以确保服务质量,更好地将客户需求和市场信息反馈给公司。凭借雄厚的技术力量、先进的生产工艺、完善的检测手段、新颖的设计造型、可靠的产品质量及优质的服务,产品深受广大客户的欢迎与认可。

在工业控制及电源、新能源汽车、新能源发电等领域, 公司已是多家各自行业内领军企业的主要IGBT模块和SiC模块供应商之一,公司将继续发挥本土化优势,和原有客户保持良好的合作关系,同时利用知名客户的示范效应,扩大客户数量,提高在已进入细分领域的市场份额和市场地位,保证现有成熟业务的持续稳定增长。与此同时,公司将紧跟国家政策指引,加大新兴行业布局,重点针对新能源汽车、新能源发电等重点行业推出在制造工艺、电性能、功耗、可靠性等方面具有国际领先水平,在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力的功率器件。

根据2019年国际著名半导体领域研究及咨询公司IHS对全球功率半导体领域的市场报告, 公司在IGBT模块领域的市场占有率排全球第8位,在国内为第1位,是国内IGBT行业的领军企业。

五、对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金合理使用,同时有效防范即期回报被摊薄的风险,具体的措施包括:

(一)提升公司经营管理水平,完善公司治理结构

公司将改进完善业务流程,提高经营效率,加强对采购、销售等各环节的信息化管理,加强销售回款的催收力度,提高公司资产运营效率,提高营运资金周转效率。同时,公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,独立董事能够认真履